

Title (en)

Bath device for engraver cylinder

Title (de)

Badvorrichtung für Tiefdruckzylinder

Title (fr)

Dispositif d'un bain pour cylindre de machine à graver

Publication

**EP 1195453 A2 20020410 (DE)**

Application

**EP 01120089 A 20010821**

Priority

DE 10049113 A 20001004

Abstract (en)

Bath comprises: (i) an upper sink (23) filled with an electrolyte (25); (ii) an anode arrangement (28, 29) vertically moving in the upper sink with a metal holder holding the metal in the form of metal elements; and (iii) a bearing device (22) for horizontally holding low pressure cylinders. The metal holder is completely covered by the electrolyte in the cylinder changing phase. Preferred Features: The metal holder stands opposite at least one half of the casing surface of the cylinder during galvanizing. The metal holder surrounds the lower half of the cylinder.

Abstract (de)

Eine Badvorrichtung für die galvanische Beschichtung von Tiefdruckzylindern (21) mit einem Metall vereinigt die Vorteile von volltauchenden und halbttauchenden Bädern. Aufgrund der großen Eintauchtiefe des Tiefdruckzylinders (21) in einen Elektrolyt (25) bei gleichzeitiger Vergrößerung eines Anodenkorbs (29) ist die Übertragung einer großen Strommenge und eine damit verbundene Verkürzung der Bearbeitungszeit möglich. Zum Ein- bzw. Ausbau des Tiefdruckzylinders (21) ist sichergestellt, dass sich der Anodenkorb (29) soweit absenken lässt, dass er vollständig mit Elektrolyt (25) bedeckt bleibt, während der Tiefdruckzylinder (21) frei über dem Elektrolytniveau (31) gehalten wird. Damit kann der Tiefdruckzylinder (21) problemlos ein- bzw. ausgebaut werden, während in dem Anodenkorb (29) gehaltene Kupferdrahtabschnitte vor Oxidation geschützt sind.  
<IMAGE>

IPC 1-7

**C25D 17/02**; **C25D 17/10**; **C25D 7/00**

IPC 8 full level

**C25D 7/04** (2006.01); **C25D 17/10** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C25D 7/04** (2013.01); **C25D 17/10** (2013.01)

Cited by

WO2015055537A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE IT LI

DOCDB simple family (publication)

**EP 1195453 A2 20020410**; **EP 1195453 A3 20040908**; **EP 1195453 B1 20051207**; DE 10049113 A1 20020606; DE 10049113 C2 20030102; DE 50108292 D1 20060112

DOCDB simple family (application)

**EP 01120089 A 20010821**; DE 10049113 A 20001004; DE 50108292 T 20010821